

Orbotech Corus[™] 8M

双面成像,性能最大化



Orbotech Corus 8M 是一款全自动直接成像解决方案,旨在取代传统的连线直接成像系统。专为最先进的 HDI (包括 mSAP)和 IC 载板量产而设计,能满足超细线路的成像和出色的对位精度,为 PCB 的设计和生产创造新的机遇。

Orbotech Corus 解决方案采用经由市场验证的新技术,带来了极高的产能和良率的同时结合其精巧、密封、干净的设计理念,确保了生产过程中对于尖端性能和环保制造的要求。





优势

完全整合的自动化解决方案

- 全自动双面直接成像解决方案旨在取代传统的连线直接 成像系统
- 独特的光学设计和超强大的多波长激光系统,适用于超高速成像
- 创新的板材处理和清洁机制

卓越的分辨率和对位精度

- 超细、高度均匀的线条结构
- 高精密的设计和先进的涨缩算法确保了卓越的对位精度
- 高景深 (DOF) 确保了在多种高低不均的板子上均能实现 最佳的线路品质

智能运行,支持工业 4.0

- 高速,多靶点识别功能确保了高产能
- 智能的料号队列管理系统,简化工作流程
- 支持工业 4.0,可实现生产流程最佳化和先进的可追溯性

降低整体拥有成本(TCO)

- 结合大镜面扫描技术,实时靶点识别功能和高效自动化实现高产能
- 占地面积小,节省无尘室空间并优化生产线空间利用率
- 高效的能耗

Technologies





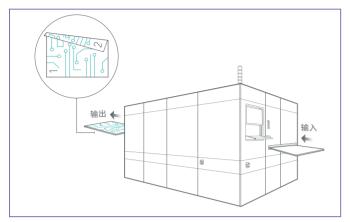
LSO™Technology



MultiWave Laser™Technology

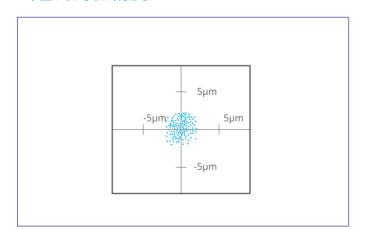


全自动双面直接成像



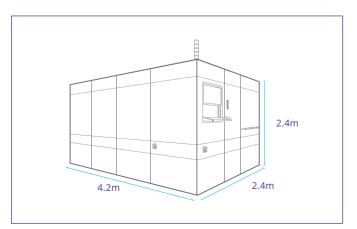
全自动,双面直接成像解决方案,最大限度地提高了批量生产的产能和良率

出色的对位精度



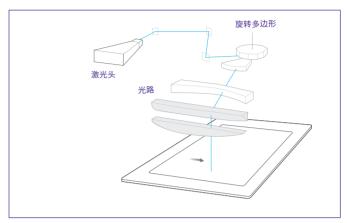
对位精度可精确至 ±5µm

精巧的一体化设计



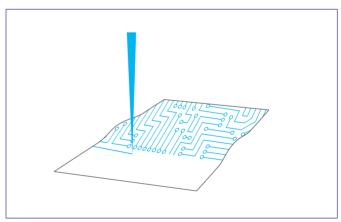
完全整合的解决方案结合其精巧、封闭的设计,干净环保的同时也提高了生产效率

高品质成像



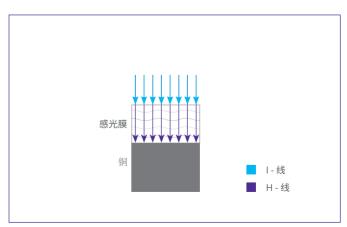
采用 KLA 经由市场验证的 LSO™(大镜面扫描)技术,单次曝光就能满足超细线路成像

高景深 (DOF)



高景深 (DOF) 确保了在多种高低不均的板子上均能实现最佳的成像精度和均匀度

支持多种感光膜



采用 KLA 经由市场验证的 MultiWave Laser™ (多波长激光)技术兼容多种感光 膜和制程



规格

Orbotech Corus 8M

最小线宽*	8µm
最小线宽+间距	20μm
边缘粗糙度, 3σ	±1µm
对位精度 (FTG), 3σ**	±5µm
层间对位精度 (FTB), 3σ**	10μm
最大基板尺寸	660mm x 660mm (26" x 26")
最大曝光尺寸	635mm x 660mm (25" x 26")
尺寸 (l) x (w) x (h)	4.2m x 2.4m x 2.4m

^{*} 取决于感光膜特性和制程 **精度基于四个目标定位

Orbotech Corus 系统是符合 IEC 60825-1-1:2022 / IEC 60825-1:2014+A11:2022 标准的 1 级激光产品